

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2014 年 12 月 11 日(11.12.2014)



(10) 国際公開番号
WO 2014/196128 A1

- (51) 国際特許分類:
B24B 37/30 (2012.01) *H01L 21/304* (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2014/002487
- (22) 国際出願日: 2014 年 5 月 12 日(12.05.2014)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2013-118245 2013 年 6 月 4 日(04.06.2013) JP
- (71) 出願人: 信越半導体株式会社 (SHIN-ETSU HAN-DOTAI CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1000004 東京都千代田区大手町二丁目 6 番 2 号 Tokyo (JP). 信越エンジニアリング株式会社 (SHIN-ETSU ENGINEERING CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1010054 東京都千代田区神田錦町 2 丁目 9 番地 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 橋本 浩昌 (HASHIMOTO, Hiromasa); 〒9618061 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字大平 1 5 0 番地信越半導体株式会社 白河工場内 Fukushima (JP). 有賀 康晴 (ARIGA, Yasuharu); 〒9618061 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字大平 1 5 0 番地信越半導体株式会社 白河工場内 Fukushima (JP). 佐々木 正直 (SASAKI, Masanao); 〒9618061 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字大平 1 5 0 番地信越半導体株式会社 白河工場

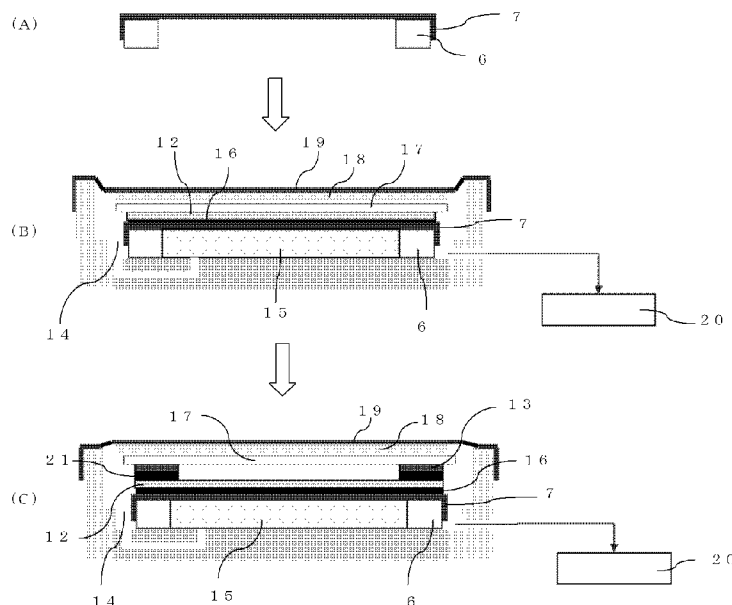
内 Fukushima (JP). 松田 隆宏 (MATSUDA, Takahiro); 〒9618061 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字大平 1 ー 3 6 5 信越エンジニアリング株式会社 白河分室内 Fukushima (JP).

- (74) 代理人: 好宮 幹夫 (YOSHIMIYA, Mikio); 〒1100005 東京都台東区上野 7 丁目 6 番 1 1 号第一下谷ビル 8 F Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI

[続葉有]

(54) Title: METHOD FOR MANUFACTURING POLISHING HEAD, AND POLISHING DEVICE

(54) 発明の名称: 研磨ヘッドの製造方法及び研磨装置



(57) Abstract: The present invention is a method for manufacturing a polishing head provided with: a backing pad for holding the reverse surface of a workpiece, the backing pad being affixed to the lower part of a rigid body; and a ring-shaped template for holding an edge part of the workpiece on the lower surface of the backing pad; the polishing head bringing the obverse surface of the workpiece into sliding contact with an abrasive cloth adhered to a surface plate, and polishing the obverse surface of the workpiece, while holding the reverse surface of the workpiece on the lower surface of the backing pad. The method for manufacturing a polishing head is characterized in having: a backing pad affixing step for affixing the backing pad onto the lower part of the rigid body using a double-sided tape under reduced pressure without heating the backing pad; and a template affixing step for affixing, after the backing pad affixing step, the template onto the backing pad using a double-sided tape or a reaction-curing solvent-free liquid or paste adhesive under reduced pressure without heating the template. A method for manufacturing a polishing head capable

of polishing a workpiece having a high degree of flatness is thereby provided.

(57) 要約:

[続葉有]

WO 2014/196128 A1



(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, 添付公開書類:
MR, NE, SN, TD, TG).

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

本発明は、剛性体の下部に接着された、ワークの裏面を保持するためのバックアップパッドと、該バックアップパッドの下面に、前記ワークのエッジ部を保持するためのリング状のテンプレートを具備し、前記バックアップパッドの下面に前記ワークの裏面を保持しながら、前記ワークの表面を定盤上に貼り付けられた研磨布に摺接させて研磨する研磨ヘッドの製造方法であって、前記バックアップパッドを加熱すること無く減圧下で前記剛性体の下部に両面テープで接着するバックアップパッド接着工程と、該バックアップパッド接着工程後に、前記テンプレートを加熱すること無く減圧下で前記バックアップパッドに両面テープ、あるいは、反応硬化型の無溶剤の液状又はペースト状の接着剤で接着するテンプレート接着工程とを有することを特徴とする研磨ヘッドの製造方法である。これにより、平坦度の高いワークを研磨できる研磨ヘッドの製造方法が提供される。